

Technische Highlights:

- Hochgenaues Achssystem (X, Y, Z) und hochauflösende Kameras
- Automatisierte Bauteilplatzierung sowie Löt- und Entlötprozesse
- Hybridheizkopf mit zwei Heizzonen
- Großflächige, leistungsstarke IR-Untenheizung in drei Zonen
- Berührungslose Temperaturmessung mit digitalem Sensor
- Drei K-Typ Thermoelement-Eingänge für Accu-TC Sensor
- Effektive Baugruppenkühlung mit Druckluft



Ersa HR 600/3P – hochpräzise, automatische Bestückung und Rework von fine pitch und Chip Bauteilen.

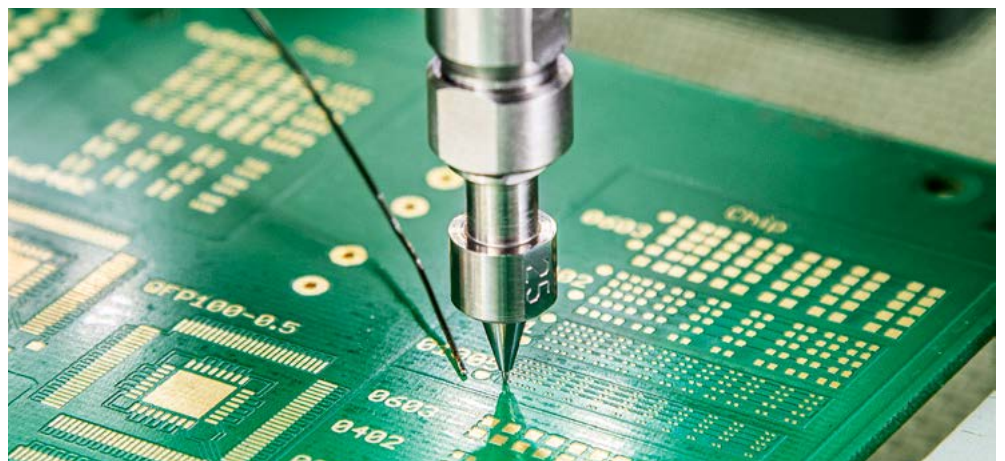
Das Ersa HR 600/3P Hybrid Rework System leistet automatisierte Baugruppenreparatur mit höchster Genauigkeit. Mit dem System sind alle Bauteilformen auf modernen Baugruppen prozesssicher zu reparieren. Besonders geeignet ist das System für sehr feine Bauteile (Raster 0,3 mm und feiner) sowie Chip Bauteile der Bauformen 0402, 0201 und 01005.

Wie beim HR 600/2 werden alle Prozessschritte automatisiert ausgeführt. Sowohl beim Achssystem als auch bei den Bauteildüsen wurde die Genauigkeit nochmals erhöht und auch die 5 Megapixel Kamerasysteme liefern die nötige Auflösung. Die Platzierung von Bauteilen erfolgt automatisch; die integrierte Bildverarbeitungssoftware wertet Bilddaten der Kameras aus. Die exakte Bauteilposition wird automatisch berechnet und das Bauteil mittels Vakuumgreifer und Achssystem platziert. Das Gerät arbeitet mit hochdynamischen Infrarot Heizelementen im Untenstrahler zur homogenen Erwärmung der Baugruppe. Der Hybrid-Heizkopf kombiniert Infrarotstrahlung und Konvektionsheizung zur gezielten

und effizienten Bauteilerwärmung. Für die Verarbeitung von Chip Komponenten eignet sich das optionale Chip Kit mit Präzisionsdüsen und einem nachrüstbaren, manuellen Gurtfeeder. Das System ist zur Aufnahme eines Ersa Dip & Print Rahmens vorbereitet, die Bauteilbedruckung mit Lotpaste erfolgt extern an der Ersa Dip & Print Station; das Dip-In eines Bauteils in ein Flussmitteldepot wird voll automatisch realisiert.

Zur Prozessbeobachtung und Dokumentation steht optional eine leistungsfähige Reflow-Prozess-Kamera mit LED Beleuchtung zur Verfügung. Die Bediensoftware HRSoft 2 (für Windows™) begleitet den Anwender bei allen Arbeitsabläufen und dokumentiert diese. HRSoft 2 ist vorbereitet für die Anbindung an kundenseitige MES Systeme.

Platzieren eines 01005 Bauteils.



Technische Daten:	
Abmessungen (B x T x H):	850 x 660 x 573 mm
Gewicht	ca. 70 kg
Ausführung antistatisch	ja
Nennleistung	3.200 W
Nennspannung	220 V – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 16 A
Oberheizung	Hybridstrahler 800 W, in zwei Zonen, 60 x 60 mm
Untenheizung	IR-Strahler (3 x 800 W), 380 x 270 mm
Messkanäle	3 x K-Typ, 1 x IRS
Positionslaser	Klasse II
Leiterplattengröße	bis 390 x 300 mm (+x)
Bauteilgröße	Chip 01005* bis 60 x 60 mm
Platziergenauigkeit	bis +/- 25 µm
Platzierkamera oben	5 MP GigE Farbkamera,
Bauteilkamera unten	5 MP GigE Schwarzweiß Kamera
Arbeitsabstand	30 – 60 mm zur Oberheizung, 35 mm zur Untenheizung
Druckluftanschluss	6 – 10 bar (ölfrei), ¼ Zoll Schnellkupplung
Prüfzeichen	CE
Bediensoftware	HRSOft 2 – geeignet für Windows 8 und Windows 10
Option – Reflow Prozess Kamera	10,7 MP, CMOS GigE Farbkamera, 50 mm Brennweite, Beleuchtung 2 x LED, regelbar

* weiteres Zubehör wird benötigt



hier finden Sie weitere Informationen



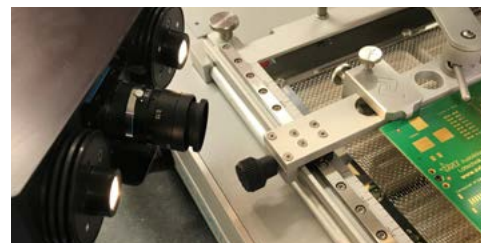
Ersa HR 600/3P Hybrid Rework System – automatische Reparaturprozesse von 01005 bis 60 x 60 mm.

Bestellinformation:

Artikelnummer	Beschreibung
0HR600/3P	Ersa HR 600/3P Hybrid Rework System
0HR610/3P	RPC Kamera HR 600/3P
0PR100	DIP & PRINT STATION komplett
0HR600/3PL	Ersa HR 600/3P mit Leiterplattenhalter XL 535 x 300 mm (+x)
0HR600/3PBHL	Ersa HR 600/3P mit abgesenkter Heizkassette (65 mm)
0HR600/3PLBHL	Ersa HR 600/3P mit Leiterplattenhalter XL & abgesenkter Heizkassette (65 mm)



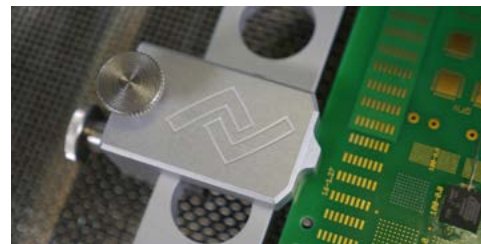
Platzieren eines metallischen BGA.



Optionale Reflow Prozess Kamera.



HRSOft 2 mit integrierter Benutzerführung.



Flexible Leiterplattenhalterung.

